

半导体

22H1 国内设备龙头中标同比涨势乐观，H2 材料板块性机会显现

本周行情概览：本周半导体行情跑输主要指数。本周申万半导体行业指数下跌 6.25%，同期创业板指数下跌 2.03%，上证综指下跌 3.81%，深证综指下跌 3.47%，中小板指下跌 4.27%，万得全 A 下跌 3%。半导体行业指数跑输主要指数。

半导体各细分板块多有下跌。半导体细分板块中，封测板块本周下跌 0.4%，其他板块本周下跌 1.4%，半导体材料板块本周下跌 1.5%，分立器件板块本周下跌 1.5%，半导体设备板块本周下跌 2.8%，半导体制造板块本周下跌 3%，IC 设计板块本周下跌 5.1%。

我们坚定看好半导体全年的结构性行情，看好 H2 材料板块的显性机会。存储原厂积极扩产以期进一步缩小与三星、美光等先进企业的产能差距，占领国内市场份额，近期长存、长鑫积极推进扩产，产能扩张+工艺改进对于前驱体、靶材等的需求将同步成倍增长，为国产各类材料厂商提供强劲成长机遇。

我们复盘了 4-5 月我国半导体进出口情况及 6 月芯片景气度+国产半导体设备招中标情况，看好国产替代大趋势下，A 股半导体设备材料的高成长潜力。

1) 6 月全球芯片平均交货周期达 27.1 周（约 6.3 个月），与 5 月持平且保持高位，但芯片供需格局局部有所“松动”。供需变化尚未传导至上游设备、材料及代工环节，调整或将于下半年到来。台积电 Q2 实现营收 181.6 亿美元，同比+36.6%，环比+3.4%，再创新高。车载+HPC 强劲需求拉动下产能保持满载。台积电三季度营收指引中点突破 200 亿美元，其预计自身供不应求情况或仍将持续。原厂结构性短缺持续，一方面，英特尔、AMD、英伟达及三星等厂商对于需求前景给出“悲观”预期，另一方面，欧姆龙等工控厂商再掀起新一轮涨价潮。终端需求分化明显，消费类、家电类分销增速趋缓，工业类、汽车类芯片需求保持坚挺。

2) 伴随晶圆厂扩产节奏，本月国产设备中标量稳步提升，设备厂商在手订单充沛中期业绩捷报频传。

2022H1 北方华创可统计设备中标数量同比增长 9.73%，一季度同比增幅达 110%。我们统计 2021 年以来北方华创的历史中标数据显示，2021 全年，北方华创共有包含刻蚀设备、薄膜沉积设备等在内的 161 台设备中标上海积塔、华虹半导体等项目。2022H1 北方华创已有 124 台设备中标，其中辅助设备、高温烧结设备和抗蚀剂加工设备年初至今的中标数目已超过 2021 年统计，我们预计今年国产设备中标规模同比有望再度扩大。

华润微按预期计划增产扩能，国产半导体设备厂商获得验证机会。6 月可统计的国产半导体设备招标总数为 769 台，上海积塔、华润微分别有 589 台、180 台设备在本月进行招标。华润微于 6 月公告称公司目前正按照预期计划推进重庆 12 吋线，并扩大对无锡和重庆 8 吋线的资本性支出，从而进一步满足其产能提升需求，国产设备有望从中获得更多验证机会。**上海积塔**本月设备招标数目同比大幅增长 440.36%，冷冻机是其除尾气处理设备和真空泵外招标数最大的设备类型。

设备中标情况：6 月国产设备中标类型及公司较为分散，刻蚀设备、辅助设备中标数量相对较多。除吉姆西中标华虹的 82 台高温加热辅助设备（为管道高温加热系统）外，北方华创（含北方华创真空）6 月共有 16 台设备中标，仍居国产设备中标数量前列。中微 7 台刻蚀设备中标上海积塔，华海清科 3 台供液系统设备中标北京燕东，屹唐 5 台清洗设备中标杭州积海，上海精测、上海微电子及盛美半导体分有 1 台检测设备、抗蚀剂加工设备和和其他设备中标不同项目。

存储原厂加速扩产，国产材料板块性机会显现。NAND 厂商长江存储将于今年底投产第二座工厂，计划每月新增 20 万片存储器芯片生产能力，达产后其合计月产能将达 30 万片，长存近期产能快速扩张将带动上游原材料用量提升，不仅晶栈 Xtacking 工艺对硅片的需求翻倍，前驱体、靶材等材料均量价双升供不应求，国产各类材料厂商顺应高景气机遇成长动能充足。**上游材料板块中，**半导体硅片领军企业沪硅产业、国内靶材行业龙头有研新材、半导体材料平台型龙头雅克科技有望深度受益。

建议关注：

- 1) 半导体材料设备：有研新材/雅克科技/沪硅产业/华峰测控/北方华创/上海新阳/中微公司/精测电子/长川科技/鼎龙股份/安集科技/拓荆科技/盛美上海/多氟多/中巨芯；
- 2) IDM：闻泰科技/三安光电/时代电气/士兰微/扬杰科技；
- 3) 晶圆代工：华虹半导体/中芯国际；
- 4) 半导体设计：纳芯微/东微半导/海光信息/圣邦股份/思瑞浦/澜起科技/声光电科/晶晨股份/瑞芯微/中颖电子/斯达半导/宏微科技/新洁能/全志科技/恒玄科技/富瀚微/兆易创新/韦尔股份/卓胜微/晶丰明源/紫光国微/复旦微电/艾为电子/龙芯中科/普冉股份；

风险提示：疫情继续恶化、产业政策变化、国际贸易争端加剧、下游行业需求不及预期

证券研究报告

2022 年 07 月 17 日

投资评级

行业评级

强于大市(维持评级)

上次评级

强于大市

作者

潘暕

分析师

SAC 执业证书编号：S1110517070005
panjian@tfzq.com

骆奕扬

分析师

SAC 执业证书编号：S1110521050001
luoyiyang@tfzq.com

程如莹

分析师

SAC 执业证书编号：S1110521110002
chengruiying@tfzq.com

行业走势图



资料来源：贝格数据

相关报告

- 1 《半导体-行业研究周报:原材料涨价+国产替代加速，半导体材料量价齐升》2022-07-10
- 2 《半导体-行业研究周报:政策助推国产化，半导体材料的板块性机会显现》2022-07-05
- 3 《半导体-行业研究周报:估值性价比显现，掘金新能源汽车景气向上机会》2022-06-26

内容目录

1. 每周谈-H1 国内设备龙头中标同比涨势乐观，H2 材料板块性机会显现.....	4
1.1. 4、5 月半导体进出口情况：设备、硅材料进出口大幅同比提升，器件 5 月出口回升明显	4
1.2. 6 月半导体景气度情况跟踪：设备+材料环节供不应求延续，工业+汽车芯片需求持续坚挺.....	5
1.3. 6 月国产半导体设备中标情况：华创 Q1 同比+110%，H1 同比+9.73%，看好国产替代穿越周期	8
1.4. H2 材料板块性机会显现：长江存储扩产，上游材料产业链受益	12
2. 本周半导体行情回顾.....	13
3. 本周重点公司公告	15
4. 本周半导体重点新闻.....	17
5. 风险提示：	18

图表目录

图 1：中国大陆半导体进出口额情况（百万美元）	4
图 2：半导体设备进出口额情况（百万美元）	4
图 3：半导体硅材料进出口额情况（百万美元）	4
图 4：半导体器件进出口额情况（百万美元）	5
图 5：其他电子元器件进出口额情况（百万美元）	5
图 6：2022Q2 台积电 5nm/7nm 先进制程产品营收占比合计过半	5
图 7：2022 台积电 5nm 制程产品营收增速快于 7nm 制程产品.....	5
图 8：2022Q2 台积电分业务板块营收占比	5
图 9：2022Q2 台积电车载、IoT、HPC 业务环比快速增长	5
图 10：全球芯片平均交货周期（周）	6
图 11：长江存储 Xtacking 工艺	13
图 12：本周 A 股各行业行情对比（%）	14
图 13：本周子板块涨跌幅（%）	14
图 14：半导体子板块估值与业绩增速预期	14
表 2：供应链库存及价格走势	6
表 2：七类芯片产品价格下跌	6
表 3：半导体原厂供需分化	7
表 6：部分供应商降价及情况供需动态	7
表 7：2021 年初至今北方华创中标数据统计（台）	8
表 8：6 月国内部分企业招标情况统计（台）	9
表 9：上海积塔 2022 年 6 月设备招标情况	9
表 10：华润微 2022 年 6 月设备招标情况	9

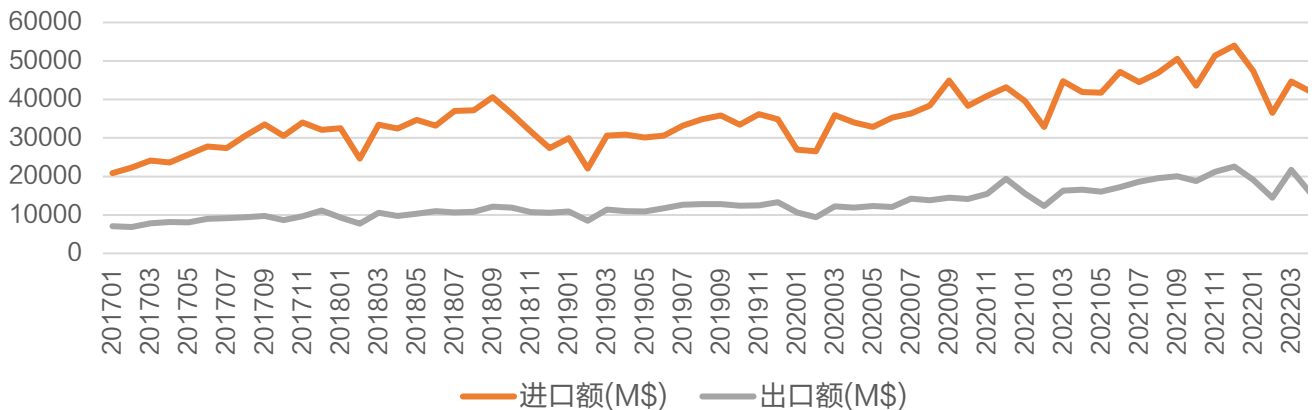
表 11: 6 月国内设备厂商中标情况统计 (台)	10
表 12: 北方华创 (含北方华创真空) 2022 年 6 月设备中标情况	11
表 13: 国内晶圆厂扩产规划	11
表 14: 国内外各环节设备厂商及市场份额对比	12
表 15: 本周半导体行情与主要指数对比	13
表 16: 本周涨跌前 10 半导体个股	14

1. 每周谈-H1 国内设备龙头中标同比涨势乐观，H2 材料板块性机会显现

1.1. 4、5 月半导体进出口情况：设备、硅材料进出口大幅同比提升，器件 5 月出口回升明显

4、5 月我国半导体进口环比持续下降，出口在 5 月有明显复苏。22 年 4 月我国半导体进口额为 420.99 亿美元，同比+0.41%，环比-5.69%，出口额为 158.44 亿美元，同比-4.25%，环比-27.12%。22 年 5 月我国半导体进口额为 396.86 亿美元，同比-5%，环比-5.73%，出口额为 184.09 亿美元，同比+14.69%，环比+16.19%。

图 1：中国大陆半导体进出口额情况（百万美元）

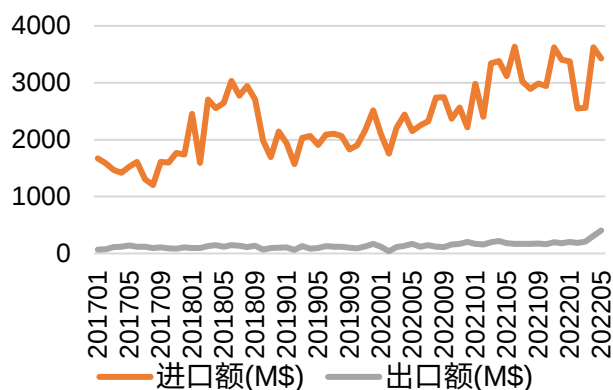


资料来源：数聚云芯，中国大陆海关公布数据，天风证券研究所

4、5 月设备进出口均有较大幅度的同比提升。4 月我国半导体设备进口额为 36.24 亿美元，同比+7.12%，环比+41.65%，出口额为 3.08 亿美元，同比 +41.09%，环比+46.53%。5 月我国半导体设备进口额为 34.25 亿美元，同比+9.79%，环比-5.49%，出口额为 4.05 亿美元，同比 +122.13%，环比+31.45%。

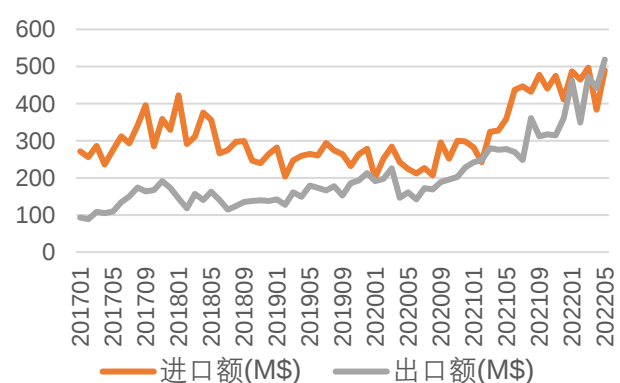
4、5 月硅材料进出口均有较大幅度的同比提升。4 月我国半导体硅材料进口额为 3.83 亿美元，同比+17.18%，环比-22.87%，出口额为 4.42 亿美元，同比+60.41%，环比-6.41%。5 月我国半导体硅材料进口额为 4.9 亿美元，同比+36.15%，环比+27.70%，出口额为 5.19 亿美元，同比+87.07%，环比+17.34%。

图 2：半导体设备进出口额情况（百万美元）



资料来源：数聚云芯，中国大陆海关公布数据，天风证券研究所

图 3：半导体硅材料进出口额情况（百万美元）



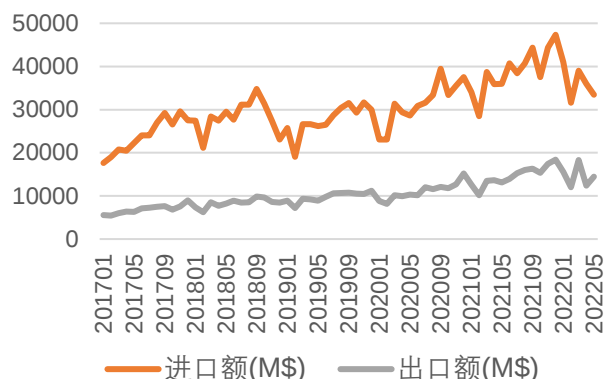
资料来源：数聚云芯，中国大陆海关公布数据，天风证券研究所

4、5 月半导体器件进口持续环比下降，5 月相对 4 月出口同比、环比均有明显回升。4 月我国半导体器件进口额为 359.55 亿美元，同比+0.09%，环比-7.92%，出口额为 123.68 亿美元，同比-9.17%，环比-32.45%。5 月我国半导体器件进口额为 334.85 亿美元，同比-6.96%，环比-6.87%，出口额为 144.33 亿美元，同比+10.08%，环比+16.7%。

4、5 月其他电子元器件进口持续同比下滑，5 月出口同比、环比均有明显回升。4 月我

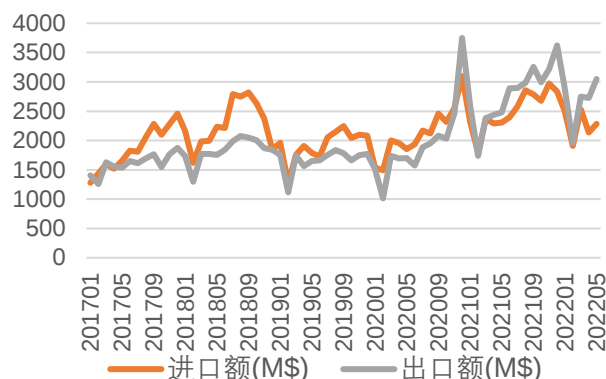
国其他电子元器件进口额为 21.36 亿美元, 同比-6.79%, 环比-15.62%, 出口额为 27.26 亿美元, 同比+11.81%, 环比-0.75%。5 月我国其他电子元器件进口额为 22.86 亿美元, 同比-0.76%, 环比+7.05%, 出口额为 30.52 亿美元, 同比+23.09%, 环比+11.94%。

图 4: 半导体器件进出口额情况 (百万美元)



资料来源: 数聚云芯, 中国大陆海关公布数据, 天风证券研究所

图 5: 其他电子元器件进出口额情况 (百万美元)

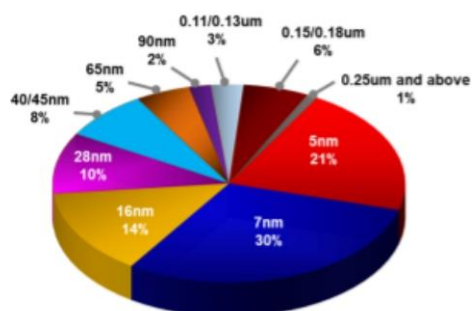


资料来源: 数聚云芯, 中国大陆海关公布数据, 天风证券研究所

1.2. 6 月半导体景气度情况跟踪: 设备+材料环节供不应求延续, 工业+汽车芯片需求持续坚挺

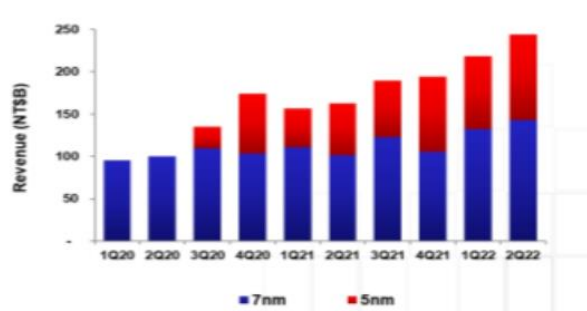
台积电 22Q2 营收接近业绩展望上限, 车载+HPC 强劲需求拉动下产能保持满载。消费疲软无碍代工龙头业绩增长, 台积电 Q2 实现营收 181.6 亿美元, 同比+36.6%, 环比+3.4%, 再创新高。台积电 5nm/7nm 等先进制程产品此前曾经历两轮调涨, 22Q2 出货占比分别为 21%/30%, 同需求强劲的车载/HPC 市场一并构成其强势增长的驱动力。台积电三季度营收指引中点突破 200 亿美元, 其预计自身供不应求情况或仍将持续。

图 6: 2022Q2 台积电 5nm/7nm 先进制程产品营收占比过半



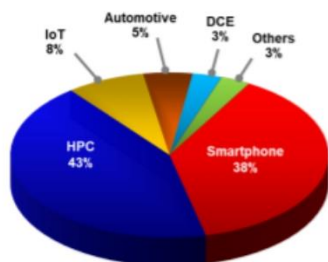
资料来源: 台积电 22Q2 Presentation Release, 天风证券研究所

图 7: 2022 台积电 5nm 制程产品营收增速快于 7nm 制程产品



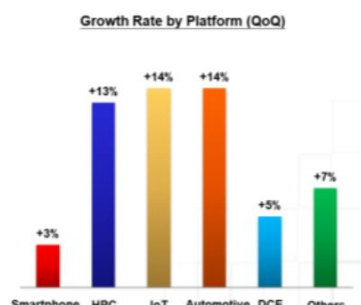
资料来源: 台积电 22Q2 Presentation Release, 天风证券研究所

图 8: 2022Q2 台积电分业务板块营收占比



资料来源: 台积电 22Q2 Presentation Release, 天风证券研究所

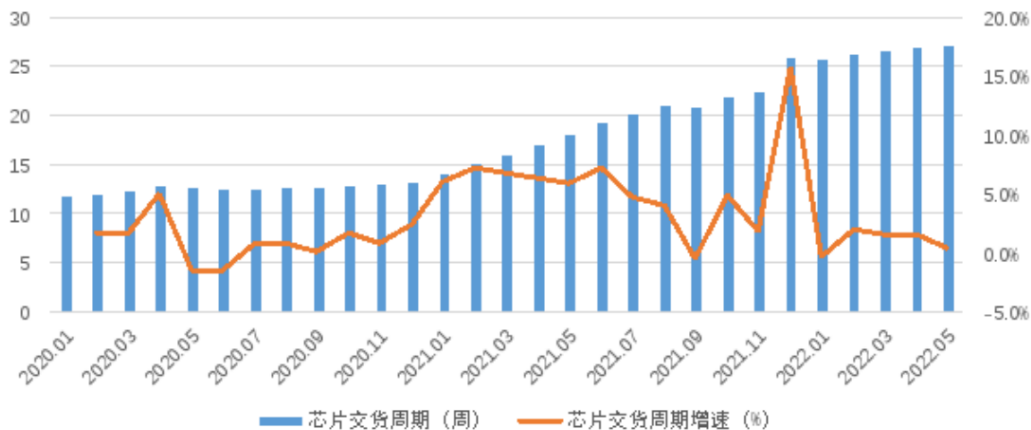
图 9: 2022Q2 台积电车载、IoT、HPC 业务环比快速增长



资料来源: 台积电 22Q2 Presentation Release, 天风证券研究所

6 月全球芯片平均交货周期与 5 月持平仍维持高位, 达 27.1 周 (约 6.3 个月)。截至目前全球性缺芯问题仍在持续, 产品需求继续分化, 家电、消费类电子景气度有待提振, 工控、车规芯片的需求仍保持坚挺。

图 10：全球芯片平均交货周期（周）



资料来源：颖特新科技，天风证券研究所

①从供应链中各细分环节来看，虽然芯片供需出现一定松动，但上游材料、设备订单充沛，晶圆代工产能利用率仍处高位。终端应用方面，汽车、工控、消费电子（手机、PC 及平板等）和家电的需求持续分化，带来了分销增速的放缓和原厂的结构性缺货，最先导致了封测增速的下滑，但供需变化还未传导至上游的材料、设备领域，代工环节的产能利用率仍处高位且有涨价预期。

表 1：供应链库存及价格走势

类别	代表企业	产能利用率	库存趋势	价格趋势
设备及材料	ASML、环球晶圆等	高	低	上涨
设计（原厂）	TI、ST、高通及联发科等	较高	低	稳定
晶圆代工	台积电、联电及中芯国际	高	-	上涨
封测	日月光、长电科技等	一般	-	稳定
分销	艾睿、大联大、深圳华强等	-	较低	-
终端应用	消费电子	较低	高	下跌
	汽车	极高	较低/无	上涨
	工控	高	低	上涨
	新能源	-	-	-
	家电	较低	高	下跌

资料来源：颖特新科技，天风证券研究所

②原厂及终端方面，缺芯问题得到结构性缓解，不同产品的供需持续分化，部分芯片出现跌价，部分芯片则延续涨价态势。以 MCU 芯片为例，车用 MCU 的需求仍居高不下，消费型 MCU 因消费市场需求不旺，厂商面对库存压力，持续降价。根据 TrendForce 分析师曾冠玮和中国半导体论坛，4、8、16、32 bit 通用型 MCU 中，汽车仅使用 8、16、32 bit，8、16、32 bit MCU 价格相对平稳。而 4 bit MCU 因绝大部分都是消费电子用，从 4 月起已开始看到较明显的降幅达到月减 15.9%、5 月也有 10.4% 的降幅、6 月降幅则是来到 11.3%，三个月的降幅就逼近了四成。

表 2：七类芯片产品价格下跌

产品	跌价原因及状况	跌价幅度	跌价对应期间
模拟芯片	产能短缺缓解、清库存使市场价格下跌	最高达 80%	2022 年初至今
三极管	终端需求降低、供不应求情况减少	20%-40%	2022 年 5、6 月价格平均跌幅
驱动芯片	面板需求减少、驱动 IC 需求下滑	20%-40%	2022 年 5、7 月价格平均跌幅
MCU	消费电子采购量下滑，冲击市场需求	近 40%	2022 年 4、5、6 月
DRAM	库存水位提升，调整库存为主	10%-20%	2022 年 Q1 末至今
NAND Flash	终端产品出货下滑，需求转取保守	5%-10%	2022Q3
GPU	生产成本降低，虚拟货币挖矿需求降低	10%-20%	AMD 2022 年 Q1 平均每月跌幅约 13%，部分跌幅达 22%

资料来源：中国半导体论坛，天风证券研究所

终端需求分化，消费、家电类率先面临降价，工控+汽车板块持续坚挺。从工业、汽车供

应原厂最新供需动态看，终端缺芯问题仍较为严重，或将延续至 2023 年。消费电子及家电方面，TI、ST、英伟达、AMD、高通、三星、SK 海力士、合泰及三环等企业均出现了降价，产品涉及 MCU、PMIC、GPU、手机 SOC、显示驱动 IC、存储及 MLCC 等，下半年或将继续面临去库存化和跌价的压力。

表 3：半导体原厂供需分化

原厂	供需/动态	重点应用领域
TI	Q1 工厂能满足自身 80%需求；Q3 芯片产能将缓解，电源管理 IC 价格或下跌	工业、汽车、消费电子
英飞凌	Q1 挤压订单额达 370 亿欧元，超 50%为车规料，25%订单今年内无法交付	汽车、消费电子
安森美	车用 IGBT 订单已满，且不再接单	汽车、消费电子
恩智浦	在手订单远超供应能力	汽车、消费电子
英特尔	芯片短缺问题恐将再持续 18 个月	消费电子、工业
ADI	芯片依旧供不应求	消费电子、工业
ST	2023 年产能排满，需求超供应 30%-40%，主要客户来自汽车及工业	工业、消费电子、汽车
萨瑞	2022 全年已确认订单在增长	汽车、消费电子
联发科	下半年削减约 8 万片 6nm 和 4nm 晶圆订单，约占 5G SoC 全年需求 20%	消费电子、工业
英伟达	对需求持悲观预期	消费电子、汽车
高通	高端骁龙 8 系列下半年砍单约 10%-15%	消费电子、汽车

资料来源：颖特新科技，天风证券研究所

表 4：部分供应商降价及情况供需动态

类别	企业	代表料号	应用领域	价格变化	动态
SOC	高通	SM8450、SM8475	消费电子	降价 30-40%	削减骁龙 8 Gen 1 下半年订单约 10-15%
	联发科	天玑 9000	消费电子	小幅度降价	下半年削减约 8 万片 6nm 和 4nm 晶圆订单
	联咏	-	消费电子、家电等	预期三季度降价	需求下滑，短期库存提升
显示驱动 IC	奇景光电 (Himax)	-	消费电子、家电等	部分经销商已筹备调价	消费类需求下滑，Q2 营下降或达 20%
	天德钰	-	消费电子等	部分产品均价下滑	2021 年以来产销量下滑
	格科微	-	消费电子等	或降价	库存陡升，公司对于驱动 IC 毛利率情况保持谨慎态度
	韦尔股份	-	消费电子、家电及汽车等	部分产品均价下滑	库存陡升，议价力减弱
GPU	英伟达	RTX 30 系列、RX6000 显卡	消费电子、汽车等	RTX 30 系列显卡低于发行价	需求前景持“悲观”态度
	AMD	AM DRX 6600	消费电子等	旗下显卡整体均价下滑 18%	-
MLCC	国巨	-	消费电子等	消费类产品价格倒挂 25%，车规级较坚挺	重点扩产车用领域产品
	三星电机	-	消费电子等	消费类产品价格倒挂 20%	车规及通信类产品大幅扩产
	火炬电子	-	消费电子等	没有提价的预期	消费、通讯类整体需求下滑
	风华高科	-	消费电子等	产品价格倒挂 10%-15%	消费类需求疲软
	三环	-	消费电子等	产品价格倒挂 10%以上	存在一定库存风险
存储芯片	三星	-	消费电子等	Q3NAND Flash 价格或下跌 5~10%	仍持续维持原有的产能扩张计划
	SK 海力士	BJR-VKC	消费电子等	BJR-VKC 等降价幅度明显	需求疲软，产品单价下滑
	镁光	-	消费电子等	-	库存偏高，下半年恐以价换量

	长江存储	-	消费电子等	Q3 价格将出现持平或涨幅收敛	下半年增加投片规划
PM IC	T I	TPS 61021	消费电子、家电等	2021 均价 45 元 1 颗至今降至 3 元 1 颗	Q3 芯片产能将缓解
		TPS 61021 ADS GR	通用消费类	2021 最高 45 元 1 颗至今降至 5 元 1 颗以下	
		TPS 63070 R NMR	通用消费类	2021 最高 90 元 1 颗至今降至 15 元 1 颗左右	
	圣邦微	-	消费电子等	-	2021 年库存同比增长 101.88%
	思瑞浦	-	消费电子等	-	2021 年库存同比增长 186.22%
消费类 MCU		HT66F002	消费电子	21.6 均价 4-5 元 1 颗降至 1.5 元 1 颗	公司通过价格调整应对消费类 MCU 降价
	合泰	HT66F004 系列	家电	从正常订单排期时 3 元 1 颗降至 1.8-2 元 1 颗	公司通过价格调整应对消费类 MCU 降价
		HC89F0421	家电	21.6 高点 3.5 元 1 颗降至 1.3-2 元 1 颗	-
	芯圣	-	消费电子、家电	2022 年以来均未出现涨价	产品物流延长, 存货周转大幅增加
	兆易创新	-	家电、工业	2022 年以来均未出现涨价	库存有所上升
	国民技术	-	消费电子、家电	2022 年以来均未出现涨价	-
	中微				

资料来源: 颖特新科技, 天风证券研究所

1.3. 6 月国产半导体设备中标情况: 华创 Q1 同比+110%, H1 同比+9.73%, 看好国产替代穿越周期

2022 年半年度国产半导体设备中标情况 (以北方华创为例)

北方华创 2022 年半年度可统计设备中标数同比+9.73%, 其中 Q1 同比+110%。我们统计 2021 年以来北方华创的历史中标数据显示, 2021 全年, 北方华创共有 161 台设备中标, 其中有 42 台刻蚀设备、28 台薄膜沉积设备、24 台热处理设备、21 台清洗设备和 21 台真空设备等中标上海积塔、华虹半导体等不同项目。2022 年半年度已有 124 台设备中标各项目, 同比+9.73%, 我们预计今年国产设备中标数目将有望进一步提升。

表 5: 2021 年初至今北方华创中标数据统计 (台)

月份	薄膜沉积设备	辅助设备	高温烧结设备	溅射设备	抗蚀剂加工设备	刻蚀设备	其他	清洗设备	热处理设备	真空设备	总计
2021 年	28	1	3	3	1	42	17	21	24	21	161
1 月	1					2	1		6	1	11
2 月										4	4
3 月	1					3			1		5
4 月	1			1		3			1	9	15
5 月	8			1		15	8	7	15	3	57
6 月						3	5	12		1	21
7 月	1					1		2			4
8 月	4					3	2				9
9 月	2		1	1		3	1			1	9
10 月			2								2
11 月	7	1				8				1	17
12 月	3				1	1			1	1	7
2022 年	6	34	8	3	6	32	15	13	6	3	126

1 月	1		3		2	2	3			11
2 月	1	1		2		4		1	6	16
3 月	1					3	3	7		15
4 月	1	20			4	19	8	4		57
5 月	1		5	1		1		1		9
6 月	1	12				2	1			16
7 月		1				1				2
总计	34	35	11	6	7	74	32	34	30	287

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所

6 月国产半导体设备招中情况梳理

华润微按预期推进扩产增能，利好国产半导体设备厂商。6 月可统计的国产半导体招标设备共计 769 台，上海积塔、华润润安位居前列。华润微于 6 月公告称公司重庆 12 吋线目前按照预期计划推进，对无锡和重庆的 8 吋线均规划了资本性支出以扩大产能，国产设备有望获得更多验证机会。据我们统计，6 月以来，积塔、华润微及其子公司华润上华、华润微重庆、华润润安等都有设备进行招标。根据部分已披露中标信息，北方华创（含北方华创真空）、屹唐半导体、中微、华海清科等有多台设备中标，盛美、上海精测等有 1 台设备中标。

表 6：6 月国内部分企业招标情况统计（台）

设备类型	华润润安	华润上华	华润微电子	华润微重庆	上海积塔	总计
薄膜沉积设备					1	1
辅助设备		1	1	6	30	38
后道设备	113					113
检测设备	14		24	3	4	45
其他	7					7
清洗设备	3	2		3		8
热处理设备		3			27	30
真空设备					527	527
总计	137	6	25	12	589	769

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所

上海积塔 6 月共招标设备 589 台：较上月招标总量 109 台增加 480 台，不同于上月采购以清洗、刻蚀、检测等主要工序设备为主，本月采购重点为真空设备（527 台真空泵），热处理设备、和辅助设备。

表 7：上海积塔 2022 年 6 月设备招标情况

招标企业	设备类型	招标设备	设备台数
上海积塔	真空设备	严苛工艺真空泵	205
上海积塔	热处理设备	冷冻机	17
上海积塔	辅助设备	双燃烧+双水洗尾气处理设备	22
上海积塔	辅助设备	等离子水洗尾气处理设备	8
上海积塔	真空设备	清洁工艺和一般工艺真空泵	322
上海积塔	薄膜沉积设备	氧化硅化学气相沉积机	1
上海积塔	检测设备	线宽量测显微镜	1
上海积塔	检测设备	线宽量测显微镜	3
上海积塔	热处理设备	快速热处理设备	4
上海积塔	热处理设备	快速热处理设备	4
上海积塔	热处理设备	激光退火设备	2

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所

华润微（含所控股华润上华、华润润安、华润微重庆在内）6 月招标数量为 180 台：其中后道设备和检测设备是其主要招标对象。

表 8：华润微 2022 年 6 月设备招标情况

招标企业	设备类型	招标设备	设备台数
华润润安	后道设备	IGBT 粗铝线键合机	4
华润润安	后道设备	背晶研磨机	1
华润润安	后道设备	手动塑封压机	32
华润润安	检测设备	PNP 分选机	5
华润润安	后道设备	全自动 TAIKO 贴膜机	1
华润润安	后道设备	全自动 TAIKO 揭膜机	1
华润润安	检测设备	X-RAY 检查机	5
华润润安	清洗设备	钢网清洗机和全自动 Flux 清洗机	3
华润润安	其他	SMT 贴装机	7
华润润安	检测设备	CP 探针台	2
华润润安	检测设备	CP 测试仪	2
华润润安	后道设备	银浆装片机	12
华润润安	后道设备	热机锡铅焊装片机高精版	46
华润润安	后道设备	热机锡铅焊装片机普配版	15
华润润安	后道设备	背晶研磨机	1
华润上华	辅助设备	机器人作业集成系统	1
华润上华	热处理设备	快速热退火设备腔体	1
华润上华	热处理设备	快速热退火设备腔体	1
华润上华	清洗设备	Solvent PR strip 清洗机	1
华润上华	热处理设备	快速热退火设备腔体	1
华润上华	清洗设备	solvent PR strip 清洗机	1
华润微重庆	辅助设备	晶盒传输腔提升升级改造	6
华润微重庆	检测设备	晶舟颗粒检测仪器	1
华润微重庆	清洗设备	硅渣清洗设备供酸机	1
华润微重庆	清洗设备	WET 机台加装化学品浓度监测系统	1
华润微重庆	清洗设备	硅渣清洗设备供酸机	1
华润微重庆	检测设备	超声波扫描显微镜	2
华润微电子	辅助设备	有机废气处理能力提升项目	1
华润微电子	检测设备	测试设备（一批）	22
华润微电子	检测设备	晶舟颗粒检测仪器	1
华润微电子	检测设备	新增红外成像仪及工业声像仪	1

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所

6 月国产设备中标类型及公司相对分散：中微公司中标上海积塔 7 台刻蚀设备，华海清科中标北京燕东 3 台供液系统设备，吉姆西半导体中标华虹 82 台高温加热辅助设备，屹唐半导体中标杭州积海 5 台清洗设备，北方华创中标 2 台刻蚀设备和 1 台薄膜沉积设备，上海精测、上海微电子以及盛美半导体分别中标了 1 台检测设备、抗蚀剂加工设备和其他设备。分设备看，刻蚀设备、辅助设备中标数量相对较多。

表 9：6 月国内设备厂商中标情况统计（台）

公司	薄膜沉积设备	辅助设备	检测设备	抗蚀剂加工设备	刻蚀设备	其他	清洗设备	真空设备	总计
北方华创	1	12			2				15
华海清科		3							3
吉姆西半导体		82							82
上海精测			1						1
上海微电子				1					1
盛美半导体						1			1
屹唐半导体							5		5
中微公司					7				7
北方华创真空								1	1
总计	1	97	1	1	9	1	5	1	116

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所

北方华创（含北方华创真空）2022 年 6 月中标设备数 16 台，名列中标设备公司数量第

一。较上月中标总数 9 台增加 7 台，本月中标设备包括 1 台薄膜沉积设备，2 台刻蚀设备，12 台辅助设备和 1 台其他设备，采购方为江南大学、中国航发北京航空材料研究院和南京京东方。

表 10：北方华创（含北方华创真空）2022 年 6 月设备中标情况

中标企业	中标设备	设备台数	设备类型（一级）	设备类型（二级）	招标企业
北方华创	半导体深硅刻蚀设备采购及安装调试	1	刻蚀设备	刻蚀设备（干法刻蚀）	江南大学
北方华创	半导体碳化硅深孔刻蚀设备采购及安装调试	1	刻蚀设备	刻蚀设备（干法刻蚀）	江南大学
北方华创	等离子体增强化学气相沉积设备采购及安装调试	1	薄膜沉积设备	薄膜沉积（CVD）	江南大学
北方华创真空	立式真空钎焊炉	1	其他	其他（精密焊接）	中国航发北京航空材料研究院
北方华创	特殊尾气处理装置	12	辅助设备	其他（尾气处理）	南京京东方显示技术有限公司

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所

晶圆厂扩产增能大潮下国产设备厂商迎验证机遇，设备已成为半导体产业中业绩表现较突出的细分领域。集微咨询预计中国大陆未来 5 年（2022 年-2026 年）还将新增 25 座 12 英寸晶圆厂，这些晶圆厂总规划月产能将超过 160 万片，2022 年投产的 12 英寸晶圆厂数量最多，年底将有 6 座顺利投产。其中中芯国际分别在北京、上海、深圳建立了 3 座 12 英寸晶圆厂，投资额约人民币 1200 亿元。深圳厂预计 2022 年底可实现量产。同时，华虹半导体也在加速无锡 12 英寸厂的扩产，IDM 厂如华润微、士兰微等 12 英寸厂均加速扩产。晶圆厂资本开支大，筹建时间长，为国内设备厂商提供了适当的产品验证窗口期，把握扩产周期下的供货机遇有望加速半导体设备的国产替代。

表 11：国内晶圆厂扩产规划

公司	扩产厂址	投资	扩产情况（月增产能）	预估产能释放时间
中芯国际	天津	-	扩增 4.5 万片 8 英寸	2021-2023
中芯国际	北京	-	新增 1 万片 12 英寸 28 纳米以上	2021-2022
中芯国际	深圳	23.5 亿元	新增 4 万片 12 英寸 28 纳米以上	2022-2023
中芯京城	北京	76 亿美元	新增 10 万片 12 英寸 28 纳米以上	2024-2025
中芯东方	上海	88.7 亿美元	新增 10 万片 12 英寸 28 纳米以上	2024-2026
华虹集团	无锡	52 亿元	扩增 6.5 万片 12 英寸 90-65/55 纳米	2021-2022
粤芯半导体	广州	65 亿元	二期扩增 4 万片 12 英寸	2021-2022
绍兴中芯	绍兴	-	扩增 9 万片 8 英寸	2021-2022
宁波中芯	宁波	-	扩增 3 万片 8 英寸	2022-2023
士兰微	厦门	50 亿元	扩增至 6 万片 12 英寸 90-65 纳米	2021-2022
士兰微	杭州	26 亿元	扩增至 8 万片 8 英寸	2021-2022
华润微	重庆	75.5 亿元	新建至 3 万片 12 英寸	2022-2024
比亚迪	长沙、济南	30 亿元	新建至 3-4 万片 8 英寸	2022-2025

资料来源：芯思想研究院，天风证券研究所

国产设备厂商订单饱满，中期业绩捷报频传，持续增长动能充足。至纯科技 7 月 6 日公告称，公司上半年新增订单总金额为 23.62 亿元，同比增长 37.33%，其中，半导体制程设备新增订单金额为 8.06 亿元。中微公司 7 月 5 日公告称，上半年新增订单金额为 30.6 亿元，同比增长 62%。华海清科近日表示，今年很多客户会新建产线，对应需求量较好，订单情况比较乐观。此外，北方华创、凯世通（万业企业控股子公司）、拓荆科技、盛美上海等半导体设备企业在手订单也很充足。可见本土头部设备厂商产品已渐得晶圆厂认可，未来伴随晶圆厂资本开支计划落地、产线投产及长期合作深化，业绩增长动能充足。

我国在各核心设备板块都涌现出了一批优质公司，国产替代进程不断加速。成本占比超过 10%的设备包括薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备、检测设备及清洗设备。薄膜沉积

设备占比设备成本 23%，我国核心公司包括北方华创、拓荆科技及中电科，光刻设备占比设备成本 22%，我国核心公司包括上海微电子装备，刻蚀设备占比 20%我国核心公司包括中微公司、北方华创、屹唐半导体，检测设备占比 12%我国核心公司包括武汉精测、上海睿励，清洗设备占比 10%我国核心公司包括华海清科、盛美半导体、北方华创。

国产设备正当其时，多环节共同推进助力国产替代。上海微电子此前交付了中国首台 2.5D/3D 先进封装光刻机，是最新一代的设备，可以用于高端 AI 芯片，高端数据中心高性能计算领域，助力有关客户实现先进封装需求。**中微公司** 7 月公开表明在南昌高新区 14 万平方米的研发生产基地已全面封顶，计划将于 2022 年内陆续投入生产，达产后将实现年产 200 腔体 MOCVD 设备的生产能力。**精测电子** 6 月公告了聚焦于电子检测领域的募投项目，项目实施将形成公司在 Mini/Micro LED 检测设备领域的全方位产品布局。公司已实现关键核心产品技术转移和核心零部件国产化，BI 产品线高速老化产品在国内一线客户实现批量重复订单，CP/FT 产品线相关产品在国内一线客户已完成工程验证，目前正在全力交付中。**盛美半导体** 今年以来已官宣了 50 台设备采购订单，公司 18 腔 300mm Ultra C VI 单晶圆清洗设备已成功投入量产，支持先进逻辑、DRAM 和 3D NAND 制造所需的大多数半导体清洗工艺。国产设备厂商受益国产化浪潮，加速发展持续攻关。

表 12：国内外各环节设备厂商及市场份额对比

设备名称	设备成本占比	全球主要厂商	国内主要厂商
薄膜沉积	23%	应用材料	北方华创
		泛林半导体	拓荆科技
		东电电子	中电科
		阿斯麦	
光刻设备	22%	尼康	上海微电子
		佳能	
		泛林半导体	中微公司
刻蚀设备	20%	应用材料	北方华创
		东电电子	屹唐半导体
		科磊	
检测设备	12%	日立	武汉精测
		应用材料	上海睿励
		应用材料	
清洗设备	10%	迪恩士	华海清科
		东电电子	盛美半导体
		泛林半导体	北方华创
		东电电子	
显影设备	4%	日立	芯源微
离子注入设备	2%	应用材料	烁科中科信
退火设备	2%	应用材料	屹唐半导体
扩散设备	1%	应用材料	北方华创
		东电电子	青岛赛瑞达
其他	5%		

资料来源：Gartner, Bloomberg Intelligence, 天风证券研究所

1.4. H2 材料板块性机会显现：长江存储扩产，上游材料产业链受益

存储原厂积极扩产能抢占市场，上游材料厂随之受益。根据全球半导体观察，国内 NAND 厂商长江存储将于今年底投产第二座工厂，规划每月生产 20 万片存储器芯片，达产后与一期项目合计月产能将达 30 万片，以期以进一步缩小与三星、美光等先进企业的产能差距。预计长江存储近期产能快速扩张将带来上游原材料用量上升，其 Xtacking 工艺采用上下晶圆堆叠结构，从而大大提高对硅片的需求，目前长江存储的 128 层 3D NAND 工艺良率已改善至令人满意的水平，最近已向一些客户交付了其自主研发的 192 层 3D NAND 闪存样品，预计将在今年年底前正式推出相应产品，对于前驱体、靶材等的需求将同步成倍增长，为国产各类材料厂商提供强劲成长机遇：

沪硅产业：半导体硅片领军企业，在行业高景气+国产替代浪潮下公司硅片具备规模化先发优势+产能国内领先&快速起量+技术创新水平领先等核心竞争优势。

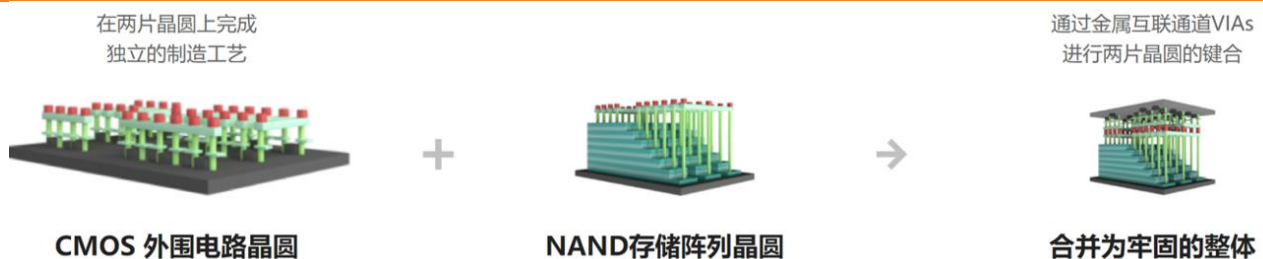
硅片行业步入供不应求长景气周期，沪硅产业具备规模化先发优势&产能快速起量优势。

上海新昇 300mm 硅片于 2021 年底实现 30 万片/月装机产能的目标，定增项目加持，投产后 300mm 产能预计翻倍，未来公司规划实现每月 100 万片的产能目标。

技术&产品比肩国际先进水准，实现工艺节点+应用领域+主流客户+产品类型 4 大全覆盖，助力获取稳定客源。沪硅产业已成为中国少数具有国际竞争力的半导体硅片企业，产品得到了众多国内外客户的认可。沪硅产业子公司上海新昇 300mm 大硅片实现 3 个全覆盖，即 14nm 及以上逻辑工艺与 3D 存储工艺的全覆盖和规模化销售、主流硅片产品种类的全覆盖、国内主要客户的全覆盖，其余子公司 Okmetic、新傲科技覆盖 200mm 抛光&外延片及 SOI 硅片，覆盖硅片全系列产品。技术方面公司不断深耕突破，如优化外延产品，消除边缘 MCLT 环，提升晶圆器件利用率、近完美单晶有效长度快速提升。

从 Xtacking 工艺架构上看，所需的晶圆数量对应的硅片数量翻倍，叠加国产替代浪潮，以沪硅产业为代表的硅片厂商将持续受益。晶栈 Xtacking 是长江存储核心专利和技术品牌，代表着长江存储在 3D NAND 存储技术领域的创新进取和卓越贡献，是长江存储面向企业客户、消费者推广 3D NAND 产品的关键所在。

图 11：长江存储 Xtacking 工艺



资料来源：半导体百科，天风证券研究所

有研新材：国内靶材行业龙头，有望在行业景气下迎来量价齐升公司产品涵盖电子信息行业用的全系列超高纯金属材料、溅射靶材和蒸发膜材，有研亿金 12 英寸超高纯铜合金靶材等新产品 2021 年通过世界一流集成电路企业验证并实现批量供货，铝钨靶材、钨靶材研发取得重要进展。有研亿金积极推进“有研亿金靶材扩产项目”实施，建成后将进一步优化和改善靶材产品结构和生产工艺，产能进一步提升至 73,000 块，提升产品盈利能力和市场占有率。在晶圆厂扩产、订单充足的背景下，公司将进入“1 到 10”的快速成长周期。

雅克科技：多元布局半导体材料的平台型公司，长存、长鑫为重要客户

公司业务范围主要涉及电子材料业务和 LNG 保温板材业务，电子材料业务方面，公司产品布局广泛，主要有半导体前驱体材料/旋涂绝缘介质（SOD）、电子特气、光刻胶、硅微粉和半导体材料输送系统（LDS）等。其中，前驱体和旋涂绝缘介质主要应用在集成电路存储芯片、逻辑芯片的制造环节，SOD 产品主要应用在半导体存储芯片的浅沟槽隔离中作为隔离填充物。2021 年，公司下属的江苏先科和 UP Chemical 公司在前驱体材料和旋涂绝缘介质（SOD）材料方面积极开拓国内、国际市场，继续维护与镁光、铠侠、Intel、台积电、中芯国际、华虹宏力、长江存储与合肥长鑫等国内外半导体芯片头部生产商原有的业务关系。

2. 本周半导体行情回顾

本周半导体行情跑输主要指数。本周申万半导体行业指数下跌 6.25%，同期创业板指数下跌 2.03%，上证综指下跌 3.81%，深证综指下跌 3.47%，中小板指下跌 4.27%，万得全 A 下跌 3%。半导体行业指数跑输主要指数。

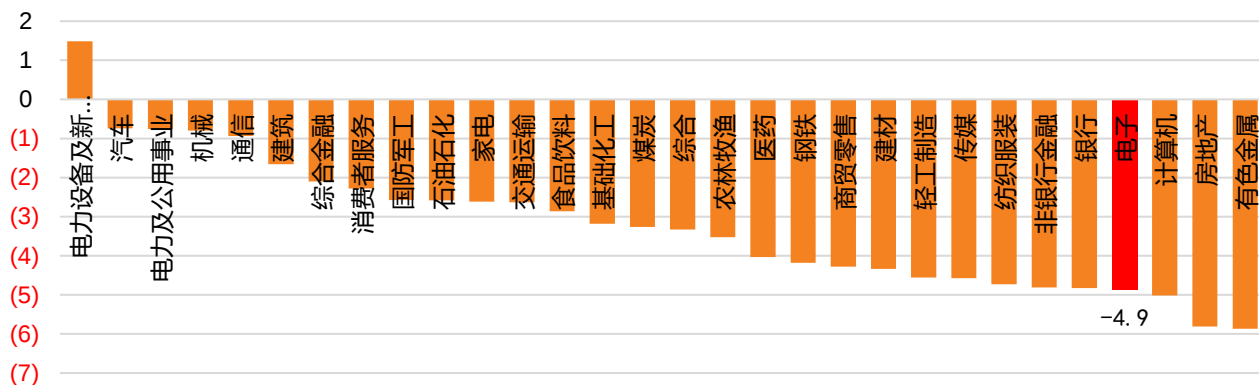
表 13：本周半导体行情与主要指数对比

	本周涨跌幅%	半导体行业相对涨跌幅（%）
--	--------	---------------

创业板指数	-2.03	-4.22
上证综合指数	-3.81	-2.43
深证综合指数	-3.47	-2.78
中小板指数	-4.27	-1.97
万得全 A	-3.00	-3.25
半导体（申万）	-6.25	-

资料来源：Wind，天风证券研究所

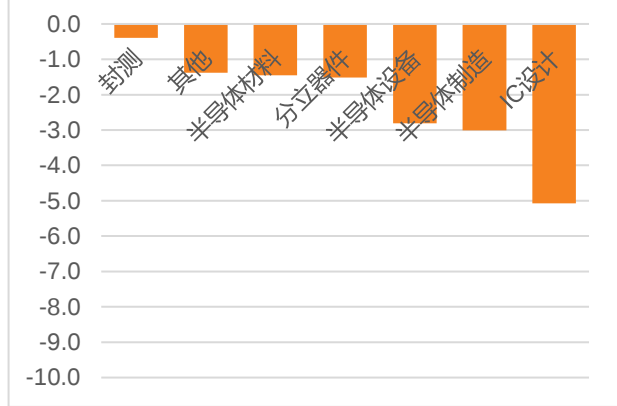
图 12：本周 A 股各行业行情对比（%）



资料来源：Wind，天风证券研究所

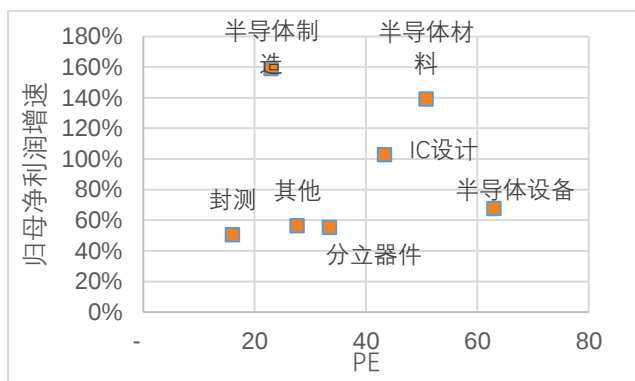
半导体各细分板块多有下跌。半导体细分板块中，封测板块本周下跌 0.4%，其他板块本周下跌 1.4%，半导体材料板块本周下跌 1.5%，分立器件板块本周下跌 1.5%，半导体设备板块本周下跌 2.8%，半导体制造板块本周下跌 3%，IC 设计板块本周下跌 5.1%。

图 13：本周子板块涨跌幅（%）



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 14：半导体子板块估值与业绩增速预期



资料来源：Wind，天风证券研究所

本周半导体板块涨幅前 10 的个股为：江丰电子、宏微科技、利扬芯片、阿石创、复旦微电、*ST 盈方、紫光国微、安路科技-U、睿能科技、新洁能

本周半导体板块跌幅前 10 的个股为：卓胜微、富满微、力芯微、晶丰明源、汇顶科技、全志科技、大港股份、国科微、芯海科技、晶晨股份

表 14：本周涨跌前 10 半导体个股

本周涨幅前 10	涨跌幅%	本周跌幅前 10	涨跌幅%
江丰电子	11.7	卓胜微	-20.3
宏微科技	6.0	富满微	-16.8

利扬芯片	4.7	力芯微	-15.0
阿石创	2.0	晶丰明源	-14.1
复旦微电	1.8	汇顶科技	-13.8
*ST 盈方	0.0	全志科技	-12.5
紫光国微	-0.2	大港股份	-12.5
安路科技-U	-1.1	国科微	-12.0
睿能科技	-1.3	芯海科技	-11.8
新洁能	-2.1	晶晨股份	-11.1

资料来源：Wind，天风证券研究所

3. 本周重点公司公告

【捷捷微电 300623.SZ】

公司于 2022 年 07 月 16 日发布《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。公告称，为更有利于地规范公司经营管理制度，进一步提升公司市场竞争力、综合实力与治理能力，完善公司战略布局，公司拟以自有资金 249.64 万元收购控股子公司捷捷新材料股东共计 40%的股权，本次股权转让完成后，公司持有标的公司的股权比例由 60%增加至 100%，捷捷新材料为全资子公司。

【恒玄科技 688608.SH】

公司于 2022 年 07 月 15 日发布《2022 年半年度业绩预告的自愿性披露公告》。公告称，公司预计 2022 年上半年实现营业收入 6.87 亿元左右，较去年同期下降 6.33%左右，预计 2022 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 8,150 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 1.08 亿元左右，同比下降 56.90%左右。主要原因系：（1）由于受到国内疫情反复和宏观经济增速放缓等多方面因素的影响，消费电子市场需求不景气，使得公司上半年营业收入有所下降；（2）公司持续投入研发，研发人员数量及新产品研发投入大幅增加，2022 年上半年公司研发费用支出 2.09 亿元左右，比去年同期增长 80%以上，使得归母净利润同比下降较多。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 2,500 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 1.1 亿元左右，同比下降 81.57%左右。

【普冉股份 688766.SH】

公司于 2022 年 07 月 15 日发布《2022 年半年度业绩预告的自愿性披露公告》。公告称，公司预计 2022 半年度实现营业收入为 5.63 亿元到 5.8 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 5,138.01 万元到 6,838.01 万元，同比增长 10.04%到 13.37%；公司预计 2022 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1.03 亿元到 1.13 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 51.55 万元到 1,016.55 万元，同比下降 0.45%到 8.96%；公司预计 2022 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 1 亿元到 1.1 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 14.20 万元到 979.20 万元，同比下降 0.13%到 8.89%。2022 年上半年，公司在原有的存储产品线领域，通过积极推进 NOR Flash 产品 40nm 工艺制程和 EEPROM 产品 95nm 及以下制程的升级及产品的迭代，持续改善单位成本，并结合 ETOX 产品的推出拓宽下游应用领域；在“存储+”产品领域，通过 32 位 MCU 和 VCM driver 等新产品的量产,丰富了产品线，提升了公司的产品竞争力和市场占有率；同时，公司努力克服国内疫情的不利影响，保证销售、研发和运营业务正常运转。综上，报告期内营业收入较去年同期略有上升。

【富满微 300671.SZ】

公司于 2022 年 07 月 15 日发布《2022 年半年度业绩预告》。公告称，公司预计 2022 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 6,700 万元 - 7,200 万元，比上年同期下降 78.81%-77.23%；扣除非经常性损益后的净利润为 4,750 万元 - 5,250 万元，比上年同期下降 84.37%-82.73%。

【斯达半导 603290.SH】

公司于 2022 年 07 月 15 日发布《2022 年半年度业绩预增公告》。公司预计 2022 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3.4 亿元至 3.5 亿元，同比增长 120.80%至 127.29%。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3.25 亿元至 3.35 亿元，同比增长 129.49%至 136.55%。业绩预增的主要原因：2022 年上半年，公司主营业务收入稳步快速增长，产品在新能源汽车、清洁能源、储能等行业持续快速放量，新能源行业收入占比从 2021 年的 33.48%提升至 2022 年上半年的 47.37%，同时，公司车规级 SiC 模块在新能源汽车行业开始大批量装车应用。2022 年上半年，公司持续加大研发投入，不断开发出具有市场竞争力的新产品，不断提升公司的综合竞争力。

【兆易创新 603986.SH】

公司于 2022 年 07 月 15 日发布《2022 年半年度业绩预增公告》。公告预计 2022 年上半年归属于上市公司股东的净利润约 15.2 亿元左右，与上年同期相比，增加 7.34 亿元左右，同比增幅 93.46%左右。公司预计 2022 年上半年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约 14.61 亿元左右，与上年同期相比，增加 7.2 亿元左右，同比增幅 97.31%左右。业绩预增的主要原因：2022 年上半年公司业绩大幅增长，主要是受益于主营业务的良好表现。公司持续优化产品结构、客户结构，继续提升工业、汽车等领域营收贡献，并通过多元化供应链布局，克服疫情对物流和产品交付的影响，从而实现销售收入和净利润快速增长。

【江丰电子 300666.SZ】

公司于 2022 年 07 月 14 日发布《2022 年半年度业绩预告》。公司预计归属于上市公司股东的净利润为 1.49 亿元-1.67 亿元，比上年同期增长：145%-175%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1.06 亿元-1.25 亿元，比上年同期增长：164.54%-209.78%。业绩预增原因：公司受益于在超高纯金属溅射靶材领域的长期研发和装备投入，形成了核心竞争力，产品进入 5nm 先端工艺，得到了国际一流客户的认可，在全球的市场份额不断扩大。同时公司受益于在半导体精密零部件领域的战略布局，持续投入研发，强化装备能力，建成了零部件生产的全工艺、全流程生产体系，抢占国产替代的市场先机，与半导体设备制造企业联合攻关并实现批量交货，新开发的各种半导体精密零部件产品加速放量。

【卓胜微 300782.SZ】

公司于 2022 年 07 月 12 日发布《2022 年半年度业绩预告》。公告称，公司预计 2022 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 7.13 亿元-7.64 亿元，比上年同期下降 29.72%-24.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7.19 亿元-7.69 亿元，比上年同期下降 27.66%-22.63%。

【南大光电 300346.SZ】

公司于 2022 年 07 月 12 日发布《2022 年半年度业绩预告》。公告称，公司预计 2022 半年度归属于上市公司股东的净利润为 1.4 亿元 - 1.52 亿元，比上年同期增长：63.70% - 77.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,000 万元 - 12,200 万元，比上年同期增长：66.99% - 85.20%。业绩预增的主要原因：公司 MO 源业务把握市场机遇，扩大产能，提高毛利，销售业绩稳步增长；公司氢类电子特气在升级品质、扩大产能；氟类电子特气业务凭借技术和产能优势，在稳固存量市场份额的同时，抢抓下游客户扩产契机，持续扩大增量市场份额。

【北方华创 002371.SZ】

公司于 2022 年 07 月 12 日发布《2022 年半年度业绩预告》。公告称，公司预计 2022 半年度实现营业收入 50.52 亿元-57.73 亿元，比上年同期增长：40%-60%；归属于上市公司股东的净利润为 7.14 亿元-8.07 亿元，比上年同期增长 130%-160%；扣除非经常性损益后的净利润为 5.96 亿元-6.86 亿元，比上年同期增长 165%-205%；基本每股收益为 1.3557 元/股 - 1.5325 元/股。业绩预增原因：2022 年上半年，受下游市场需求拉动，公司电子工艺装备及电子元器件业务进展良好，销售收入及归属于上市公司股东的净利润均实现同比增长。

4. 本周半导体重点新闻

比亚迪拟自研智能驾驶芯片。7 月 15 日，据业内媒体消息，从多位知情人士处获悉，比亚迪正计划自主研发智能驾驶专用芯片，该项目由比亚迪半导体团队牵头，已经向设计公司发出需求，同时自身也在招募 BSP 技术团队。消息称，如果进度快，该芯片年底可以流片。BSP 是板级支持包 (board support package)，作用是给芯片上运行的操作系统提供一个标准的界面。

功率器件：马来西亚投资热，英飞凌、博世再现扩产新动态。马来西亚槟城 2022 年一季度吸引了电子与电气领域 44 亿美元投资，该领域也成为马来西亚制造业中表现最强劲的细分行业。近日英飞凌位于马来西亚居林的第三工厂项目日前举行奠基仪式，该项目总投资逾 80 亿令吉（约合 121.2 亿元人民币），将用于第三代半导体碳化硅、氮化镓产品制造，预计 2024 年第三季度建成投产。博世计划在 2026 年之前向其半导体部门再投资 30 亿欧元，作为 IPCEI 微电子和通信技术资助计划的一部分。

车规芯片企业芯驰科技与半导体制造商罗姆签署战略合作。7 月 13 日，车规芯片企业芯驰科技与半导体制造商 ROHM Co., Ltd.（以下简称“罗姆”）战略合作签约仪式举行。据了解，芯驰科技与罗姆于 2019 年开始展开技术交流，并就面向智能座舱的应用产品开发建立了合作关系。此次，作为首批合作成果，芯驰科技智能座舱 SoC X9 系列的参考板上搭载了罗姆的 SerDes IC*1 和 PMIC*2 等产品，现已开始为客户提供解决方案。

Google Cloud 宣布采 Arm 架构处理器，英特尔、AMD 备感压力。Alphabet 旗下 Google Cloud 7 月 13 日宣布，将采用基于 Arm 技术的运算芯片，意味着将从英特尔、AMD 手中夺取市占率，成为新压力。Google 表示，新产品是基于安培运算（Ampere Computing）的“Altra”芯片。Ampere Computing 由前英特尔高管，主要开发 Arm 架构服务器处理器，同时也向微软、甲骨文等公司出售芯片。

车芯片免疫“砍单潮”：企业再融资瞄准车用市场。尽管近期消费类芯片进入去库存周期，但多种汽车芯片下游供需中，紧张局势却依然自 2020 年下半年来延续至今。《科创板日报》记者从多家 A 股半导体公司了解到，近期的半导体结构性需求调整，对部分产业链

环节布局较为齐全、业务条线多样的上市公司影响整体有限。其中，车用功率芯片、车用 MCU 产品等景气度依旧较高，供需紧张，有 IDM 厂商为此专门增加车规级芯片制造或封装产线。另外，今年以来，多家科创板上市公司的汽车芯片相关研发及产业化再融资项目，纷纷取得新进展。

盛美上海推出首款 Post-CMP 清洗设备 适用于硅片和碳化硅衬底制造。7 月 14 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司(以下简称“盛美上海”)，宣布推出新型化学机械研磨后（Post-CMP）清洗设备。据悉，这是盛美上海的第一款 Post-CMP 清洗设备，用于制造高质量衬底化学机械研磨(CMP)工艺之后的清洗。该清洗设备 6 英寸和 8 英寸的配置适用于碳化硅（SiC）衬底制造；8 英寸和 12 英寸配置适用于硅片制造。该设备有湿进干出（WIDO）和干进干出（DIDO）两种配置，并可选配 2、4 或 6 个腔体，拥有每小时 60 片晶圆的最大产能（WPH）。

成都士兰半导体（二期）项目芯片封装厂房封顶。据中国电子第三建设消息，2022 年 7 月 12 日，成都士兰半导体（二期）项目芯片封装厂房封顶仪式举行。消息介绍称，成都士兰半导体制造有限公司二期厂房及配套设施建设项目位于成都市金堂县淮口镇成阿工业集中发展区。该项目于 2021 年 11 月 18 日正式开工，项目投资金额为 1.6 亿元。资料显示，成都士兰重点发展 LED 芯片制造、封装、高压集成电路芯片制造、功率模块封装四项业务，是杭州士兰微电子股份有限公司着力打造的西部 LED 半导体芯片制造基地。

5. 风险提示：

疫情继续恶化、产业政策变化、国际贸易争端加剧、下游行业需求不及预期

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼
邮编：100031	A 栋 23 层 2301 房	邮编：200086	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	邮编：570102	电话：(8621)-65055515	电话：(86755)-23915663
	电话：(0898)-65365390	传真：(8621)-61069806	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com